

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2025年4月28日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华商基金、华源金属新材料
会议时间	2025年4月28日 14:00-15:00
会议地点	有研粉材
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请简要介绍2024年及2025年一季度公司各业务板块经营情况。</p> <p>A1：2024年公司各业务板块再创新高，全年销量共计约31000吨，同比增长11%，其中铜基粉体约27000吨，同比增长10%，锡基粉体约3400吨，同比增长6%，电子浆料约500吨，同比增长28%，增材制造板块包含3D打印和粉末冶金粉约800吨，其中3D打印粉末约310吨，同比增长176%。2024年合并营业收入32亿元，比去年同期增长20%，合并利润总额6397万，比去年同期增长4%。2025年一季度销量7500吨，同比增长6%，营业收入约7.9亿，同比增长20%，利润总额约1300万元，同比增长7%。</p> <p>Q2：公司3D打印板块的产品结构是怎样的？</p> <p>A2：3D打印板块产品目前基本构成是40%铝合金粉，包括铝硅十镁、铝硅七镁等；20%高温合金粉；40%其他粉末，包括钛合金粉、铜合金粉、不锈钢粉等。</p>

	<p>Q3: 公司的锡膏主要应用于哪些领域？ A3: 公司的锡膏主要应用于光伏、LED、半导体等封装、组装应用行业。光伏方面主要应用于BC电池技术。</p> <p>Q4: 公司产品还有哪些其他亮点？ A4: 公司未来研发方向是向新的应用领域拓展、延伸，也会继续延伸产业链，如铜基板块，在保持现有市占率前提下，加强新产品的研发力度，如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉等高附加值产品。如电子浆料板块，专注于超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发，增加互连材料的种类，可应用于PCB、MLCC等产品。公司结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，不断调整产品结构，开发新的应用领域，形成新的产业链，扩大市场需求。</p> <p>Q5: 电子浆料部分有什么新进展吗。 A5: 电子浆料板块新产品还处于技术研发阶段，有研纳微主要聚焦国家重大专项任务，承担未来产业的重点技术突破。目前已有产品送交客户验证，预计验证通过后每月新增吨级供货。</p> <p>Q6: 公司机器人研发合作项目进展如何？ A6: 公司前期以研发为主，承接了关于机器人项目的研究课题，如北京市科技计划项目高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究项目，主要应用于小型机器人。该产品的主要原材料为铁基粉末，采用粉末冶金工艺制作，应用于机器人关节部位。有上市公司与公司联系定制化相关零件的业务处于沟通技术指标阶段。</p> <p>Q7: 公司的导热铜粉目前供货量有多少？ A7: 公司新型导热铜粉的研发起源于下游终端客户的应用需求，属于客户定制研发的产品，应用效果截至目前反馈良好，销售量持续攀升，现已达到4至5吨的月供货量。</p> <p>Q8: 公司产品与deepseek是否有关联？ A8: 公司新型导热铜粉现已成功应用于部分GPU散热器件，据了解该产品目前也已部分应用于AI算力服务器，随着deepseek等AI应用的普及，对硬件的散热及提速要求越来越高，公司新型导热铜粉有望进一步扩大销售规模，形成新的利润增长点。</p> <p>Q9: 公司今年有哪些可以期待的方面？ A9: 除增材制造板块和电子浆料板块的持续增长外，铜基</p>
--	--

	板块随着泰国产业基地投产，产品销量逐渐达到盈亏平衡线以上，目前与大客户正在洽谈订单及框架协议，预计今年销量会有较大的增长。锡基板块的康普公司今年也已开发新客户，预计会有新的增量。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	
日期	2025年5月13日